

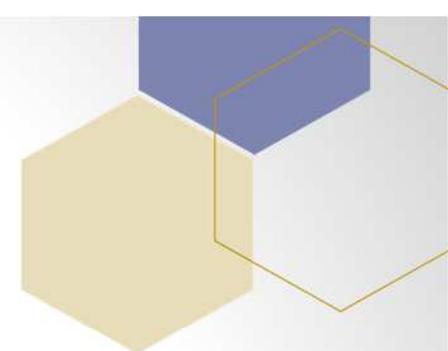
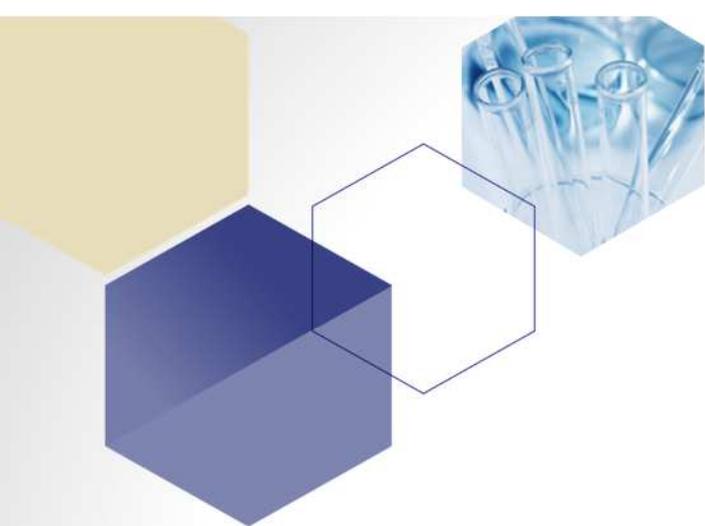
2025年3月期 第2四半期 決算説明資料



日本高純度化学株式会社

証券コード：4973

2024年10月23日



決算の概況

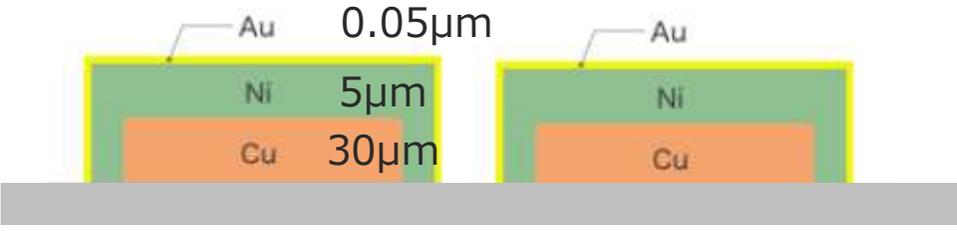
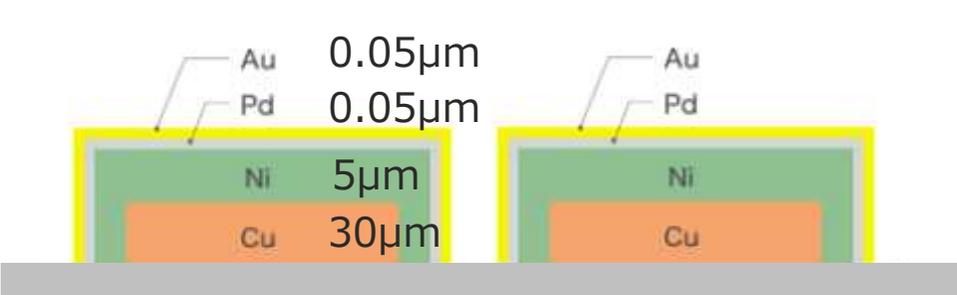
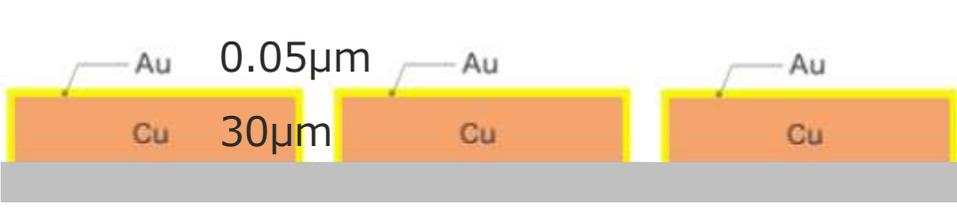
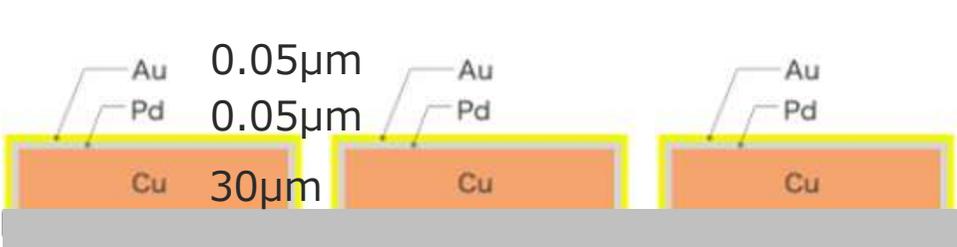
(注) 当社業績の見方のポイント

- ▶ 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合とで大きく変動します。
- ▶ 貴金属は、価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。

用語説明①（めっき方式）

用語	用途	説明
電解めっき (電気めっき)	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	プリント基板 半導体搭載基板	高純度な純金めっき
硬質金めっき	コネクタ プリント基板	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウム (Pd) めっき	リードフレーム コネクタ	金めっきの下地めっきとして使用される
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換めっき	プリント基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元めっき	プリント基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法

用語説明② (めっきプロセス)

用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Immersion Goldの略 層構成はCu-Ni-Au	 <p>Two cross-sectional diagrams of ENIG plating. The left diagram shows a substrate with a 30μm Cu layer, a 5μm Ni layer, and a 0.05μm Au layer. The right diagram shows a similar structure with a 30μm Cu layer, a 5μm Ni layer, and a 0.05μm Au layer.</p>
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略 層構成はCu-Ni-Pd-Au	 <p>Two cross-sectional diagrams of ENEPIG plating. The left diagram shows a substrate with a 30μm Cu layer, a 5μm Ni layer, a 0.05μm Pd layer, and a 0.05μm Au layer. The right diagram shows a similar structure with a 30μm Cu layer, a 5μm Ni layer, a 0.05μm Pd layer, and a 0.05μm Au layer.</p>
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Direct Immersion Goldの略 Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。層構成はCu-Au	 <p>Three cross-sectional diagrams of DIG plating. Each diagram shows a substrate with a 30μm Cu layer and a 0.05μm Au layer. The Au layer is shown as a thin coating on the Cu layer.</p>
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Palladium Immersion Goldの略 層構成はCu-Pd-Au	 <p>Three cross-sectional diagrams of EPIG plating. Each diagram shows a substrate with a 30μm Cu layer, a 0.05μm Pd layer, and a 0.05μm Au layer. The Pd and Au layers are shown as thin coatings on the Cu layer.</p>

μm(マイクロメートル) : 1mの100万分の1

製品ラインアップ ～ラインアップ拡充と新分野開拓～

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	
	硬質金 (合金)		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム(Pd)		PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame)	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元Pd		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP
周辺分野			卑金属 (銅、スズ、ニッケル) 合金めっき 後処理剤など	

2025年3月期 第2四半期決算概況

電子部品業界の状況

- 産業機器向けで設備投資に慎重な姿勢から依然需要は低迷したが、生成 A I 向けの旺盛な需要増に牽引され A I サーバやデータセンター向けで堅調に推移し、スマートフォンやパソコンなどの民生品向けにおいては緩やかながらも需要が回復
- 車載用電子部品については、電気自動車の需要鈍化から在庫調整が見られたが、ハイブリッド車や先進運転支援システムなど電装化に伴う需要増から底堅く推移

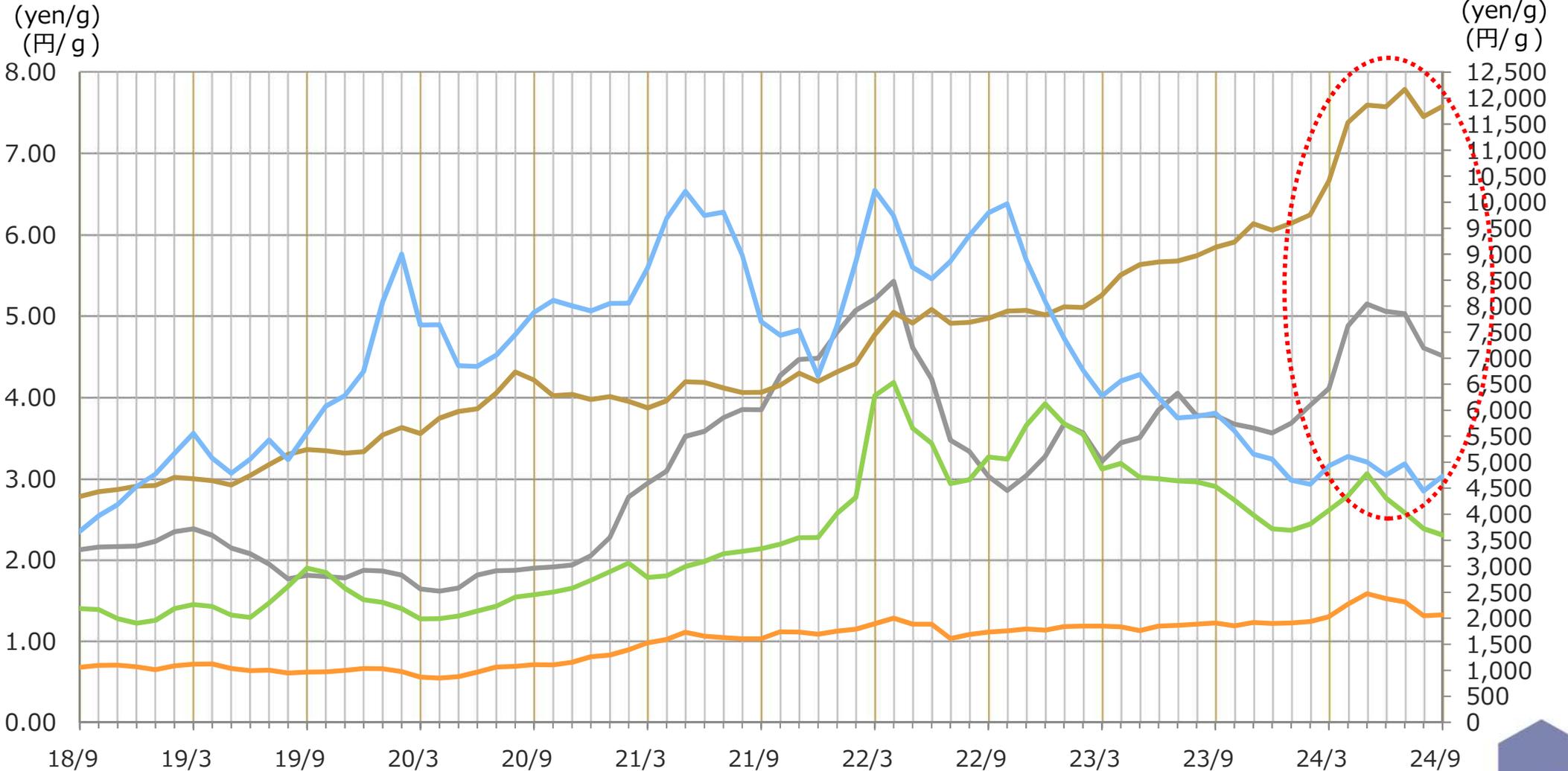
当社の概況

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品
パソコン向けやメモリ向けで足踏み感が見られたが、生成 A I 関連の半導体パッケージやモジュール向けで堅調を維持し、スマートフォン向けで底堅く推移
- コネクタ用めっき薬品
スマートフォン向けで好調も産業機械向けは低迷し、車載向けでは停滞感が見える
- リードフレーム用めっき薬品
スマートフォンやパソコン、家電向けで徐々に回復してきたが、パラジウム価格下落の影響を受けて減収

メタル相場推移

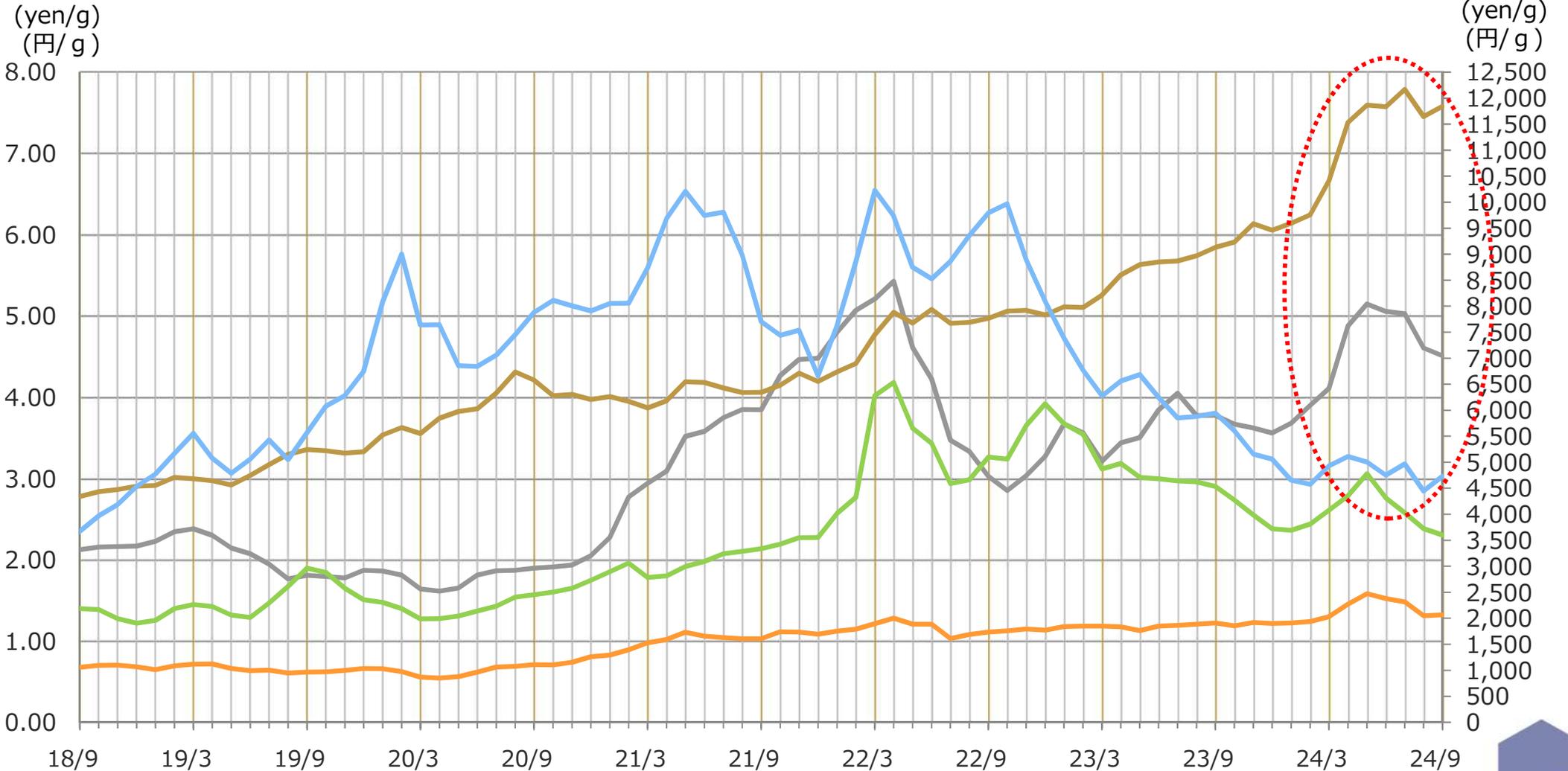
Prices of copper, tin and nickel
銅、スズ、ニッケル価格

Copper 銅
Tin スズ
Nickel ニッケル



Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格

Gold 金
Palladium パラジウム



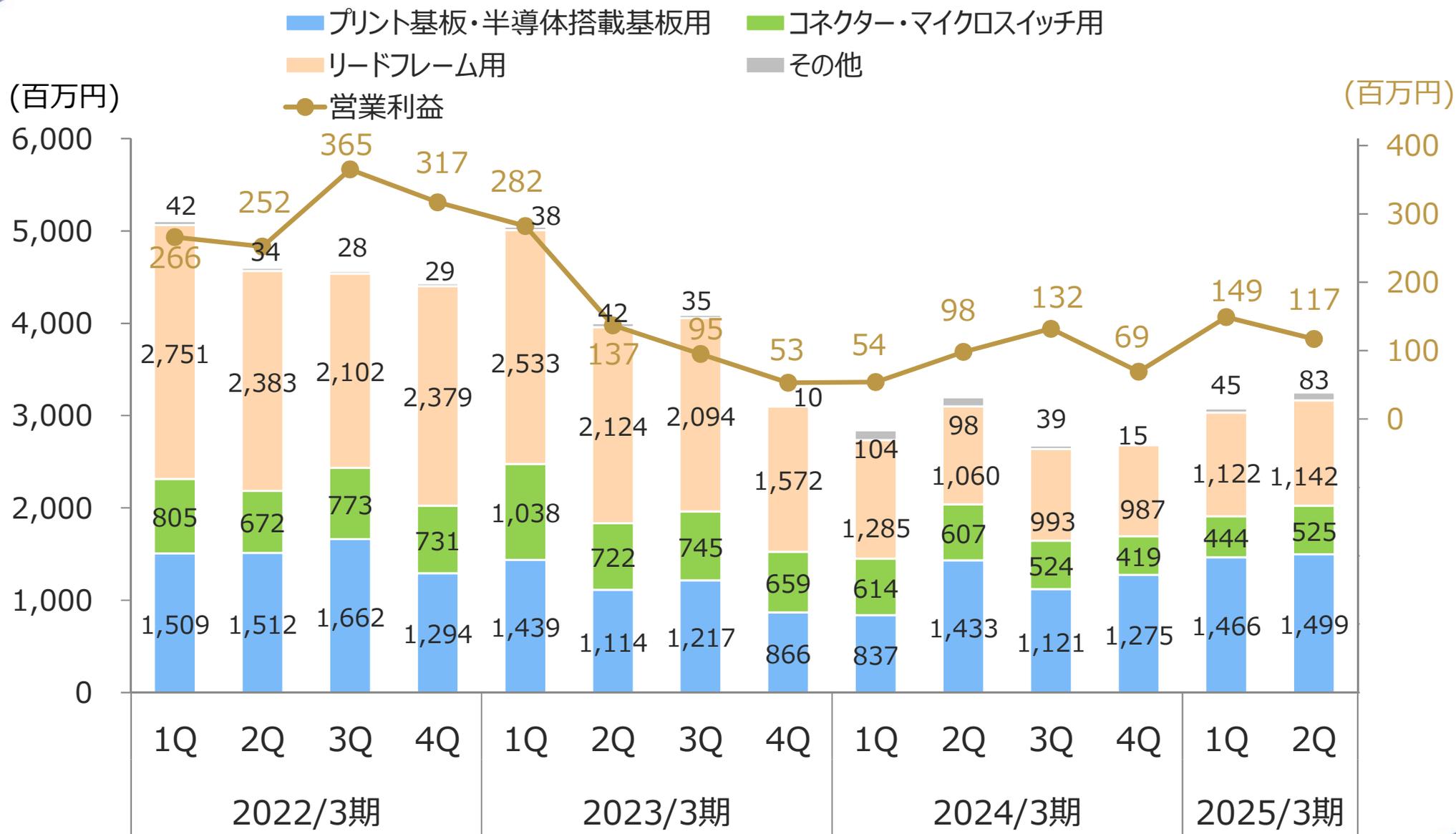
2025年3月期 第2四半期決算概況

(単位：百万円)

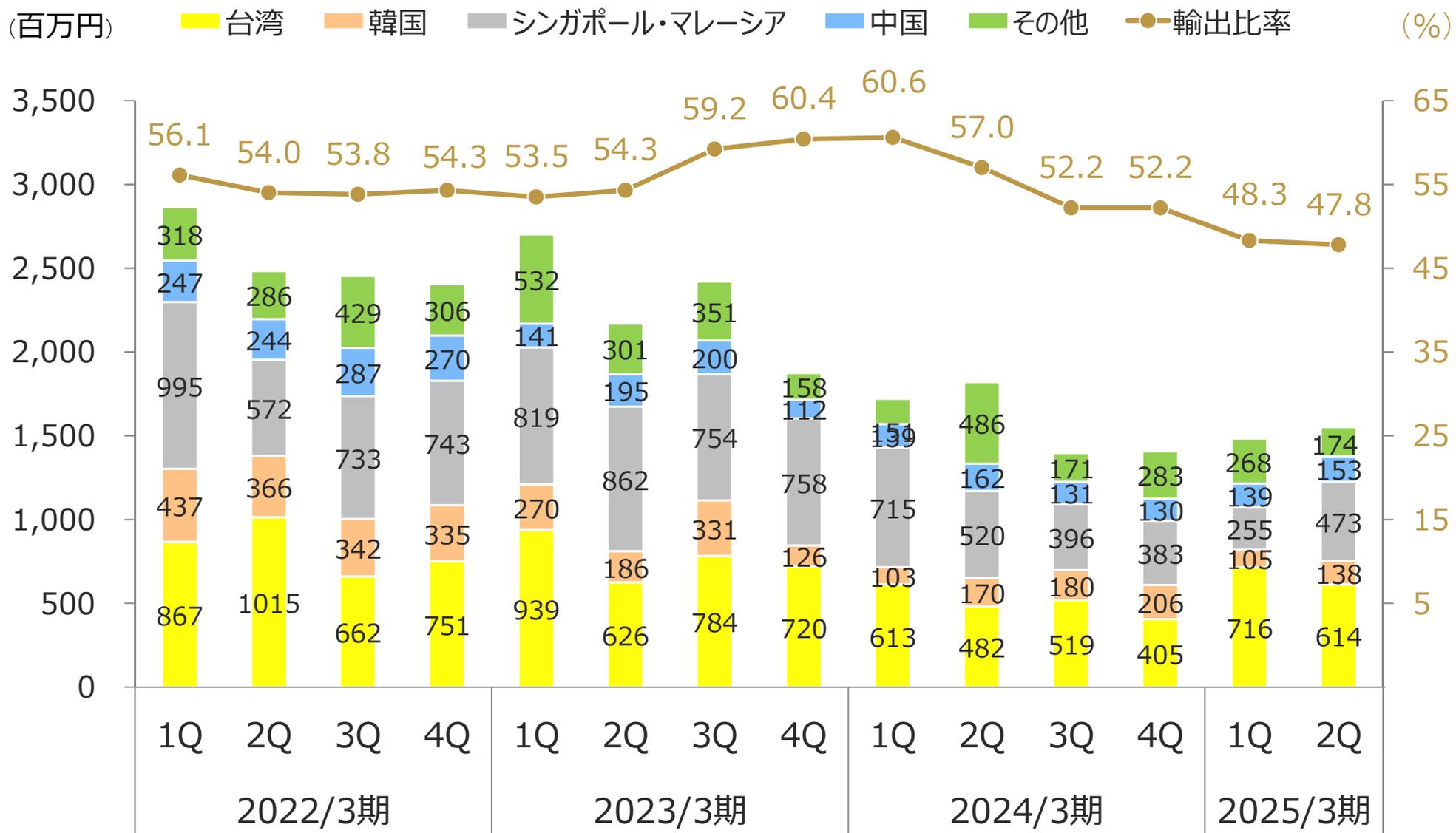
	2024/3期 2Q累計	2025/3期			
		1Q	2Q	2Q累計	増減率
売上高	6,042	3,079	3,251	6,330	4.8%
営業利益	153	149	117	266	74.1%
経常利益	262	241	118	359	37.2%
四半期純利益	202	271	550	822	306.4%
1株当たり 四半期純利益	35.16円	47.09円	95.42円	142.56円	—

- 産業機器向けの需要が低迷したものの、サーバ/データセンター向けの需要が堅調に推移したほかスマートフォンやパソコンなどの民生品向けの売上回復により、前年同期比で増収増益
- 純利益は、今年度上期に保有株式の売却益を計上したことにより、前年同期比大幅増

売上高・営業利益の推移（四半期ベース）



輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



政策保有株式売却の進捗

- 当社は政策保有株式について、「事業戦略及び取引先との事業場の関係協力、フィードバックが期待できる企業の株式のみを保有し、今後1～2年以内に純資産割合の20%未満までの縮減を図る」との方針を掲げています。 ※1
- 上記方針に沿って過去9か月間で1,202百万円の売却を実施しており、引き続き売却を進めています。

※1 2024年3月22日開示の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」参照

	2023年9月末	2023年12月末	2024年3月末	2024年6月末	2024年9月末
売却額 ※2 (百万円)	0	0	307	142	752
保有株式時価 (百万円)	7,925	8,748	8,796	9,069	7,236
純資産額 (百万円)	13,725	14,229	14,537	14,683	14,052
純資産に対する割合 (%)	57.7	61.5	60.5	61.8	51.5

※2 該当四半期中での売却額

2025年3月期 通期見通し

(単位：百万円)

	2024/3期	2025/3期			
		期初公表値 (2024年4月)	今回見込み (2024年10月)	増減率	
				前期比	4月比
売上高	11,419	13,000	13,000	13.8%	0.0%
営業利益	354	500	500	41.1%	0.0%
経常利益	553	680	680	22.9%	0.0%
当期純利益	548	580	1,580	188.2%	172.4%
配当	101円	126円	126円	+25円	±0円
ROE	3.9%	4.0%	11.3%	—	—

- サーバ/データセンター向けは生成 A I 向けの旺盛な需要増に牽引され堅調な推移を予想
- スマートフォンやパソコンなどの民生品向けは上期と同程度を見込む
- 車載向けは電気自動車の需要鈍化による減速のリスクがあり、産業機器向けは本格的な回復時期が依然として見通せない状況が継続
- 保有株式の売却に伴う特別利益を織り込み、当期純利益見込を修正

コーポレートサイトリニューアルに関するお知らせ

コーポレートサイト (<https://www.netjpc.com/>) を全面的にリニューアルいたしました



- 当社のめっき技術を動画で分かりやすく紹介しています（トップページ:Company/企業情報付近）
- 多くの皆様に当社の魅力を伝えるとともに、ステークホルダーとのコミュニケーションを深めてまいります
- 引き続き、当社の活動にご期待いただけますようお願い申し上げます

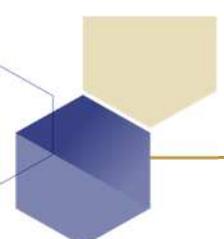
補足資料：会社紹介

沿革

- 1971年 7月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4月 東京証券取引所プライム市場に移行

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2024年9月末時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>